

平成 27 年 12 月 22 日

各 位

上場会社名 T O W A 株式会社
代 表 者 代表取締役社長 岡田 博和
コード番号 6315
問合せ先責任者 執行役員経営企画本部長
蒲生 喜代重
TEL (075) 692 -0251

新製品「CPM1180」販売開始に関するお知らせ

当社は、独自の『コンプレッション技術』を活用する事により、リードフレームや基板の大判化に対応でき、低コスト高生産性を実現する装置『CPM1180』を開発いたしました。

同時に本装置はエポキシ樹脂を用いた低コストでの基板製造用装置としても応用展開することができ、基板メーカーに対する販売も開始いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 開発背景

半導体パッケージに対するコスト競争は激しく、各半導体メーカーはリードフレームや基板サイズの大判化を進めることで高生産性・コスト低減を実現し、それに対応した半導体製造装置が要求されております。

この度、当社独自のコンプレッション技術を用いる事により、パネルサイズ□660×540 mm、ウエハサイズ 18 インチ(Φ450 mm)が成形可能な装置を開発し、業界のコスト削減ニーズに先行したソリューションを実現できる装置を提供いたします。

同時に本装置を応用展開することで、パッケージの原価構成で最大を占める基板コストの低減へ向け、高価な樹脂材を用いるのではなく、安価なエポキシ樹脂を用いた新たなプロセスを実現できる基板製造装置としても期待されております。

2. 新製品の概要

(1) 製品名

CPM1180

(2) 製品の特長

- ・樹脂の流動距離をゼロ或いは最短にする低圧成形
- ・高速高真空達成が可能なFM機能
- ・ダイダウン金型構造
- ・顆粒樹脂仕様
- ・パネルサイズ□660×540 mm、ウエハサイズ 18 インチ(Φ450 mm)の成形可能
- ・エポキシ樹脂を使用した基板製造プロセスを実現



3. 販売計画等

- ・販売開始時期 2016年1月
- ・販売目標 年間4台(2017年3月期)

以上